

2020年度(2021年3月期) 第3四半期決算概要について



Brightening the Future
Since 1946

2020年度 第3四半期決算概要（連結）

決算概況	2
ICリードフレーム部門	4
ICパッケージ部門	6
気密部品部門	8

2020年度 通期の見通し（連結）

業績予想の修正	10
売上高・損益・配当	11
設備投資額・減価償却費・研究開発費	13

決算概況

（単位：億円）

	2019年度 3Q累計	2020年度 3Q累計	前年同期比	
				増減率
売上高	1,075	1,355	280	26%
営業利益 （営業利益率）	1 (0%)	149 (11%)	148	—
経常利益 （経常利益率）	12 (1%)	161 (12%)	149	—
四半期純利益※ （四半期純利益率※）	1 (0%)	109 (8%)	109	—

※親会社株主に帰属する四半期純利益

1株当たり四半期純利益	0.48円	80.97円
-------------	-------	--------

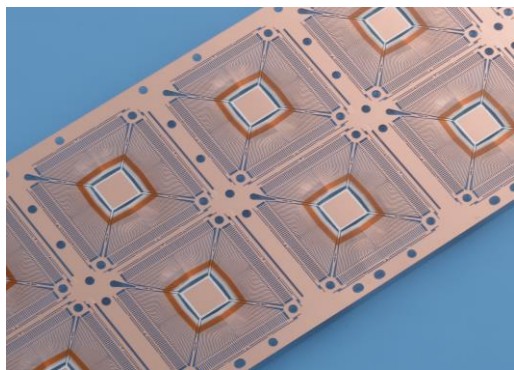
売上高：

- 新型コロナウイルス感染拡大による自動車・スマートフォン等の需要減退の影響を受けたものの、テレワーク、オンライン学習の拡大、5Gの実用化などを背景に、データセンター用サーバー向けやパソコン向けにフリップチップタイプパッケージの売上が大きく拡大し、半導体製造装置向けセラミック静電チャックの受注が大幅に増加するとともに、第3四半期に入ってリードフレームの売上が回復に転じるなど、前年同期比で26%増と大幅な増収

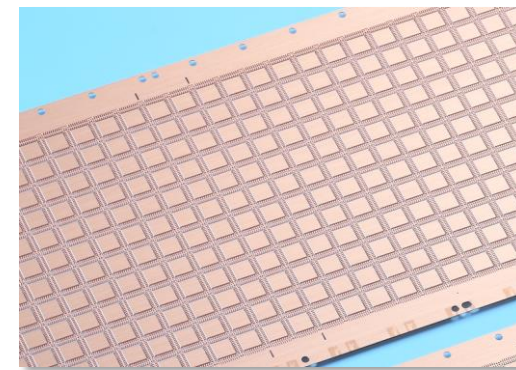
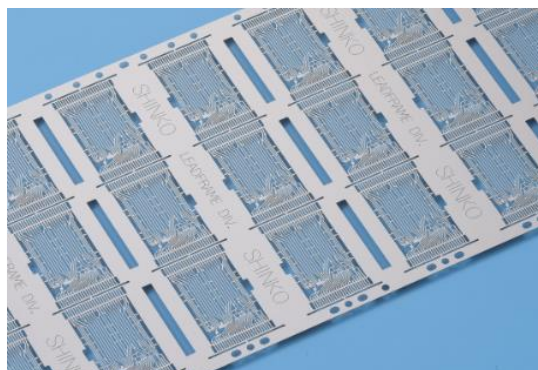
損益：

- 高付加価値製品をはじめとする売上増加による収益性の向上などにより、前年同期比で大幅な増益

ICリードフレーム部門



プレスリードフレーム



エッチングリードフレーム
(QFNタイプ)

【主な搭載製品例】

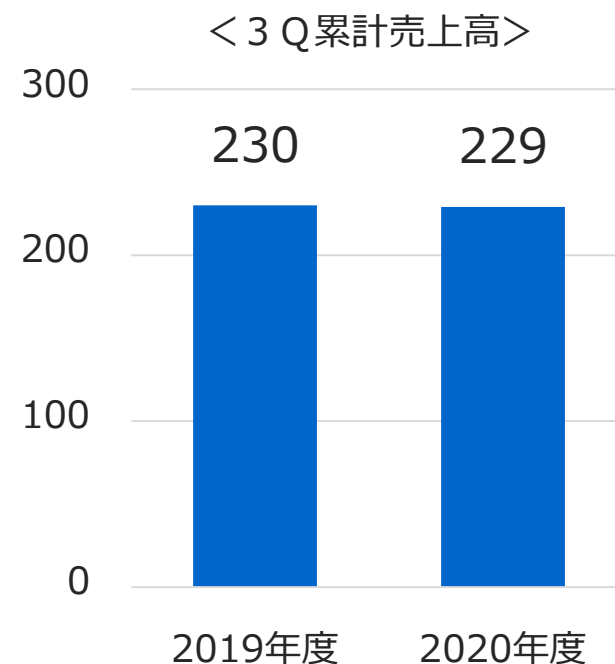
スマートフォン、自動車、パソコン、家電、産業機器 他

ICリードフレーム部門

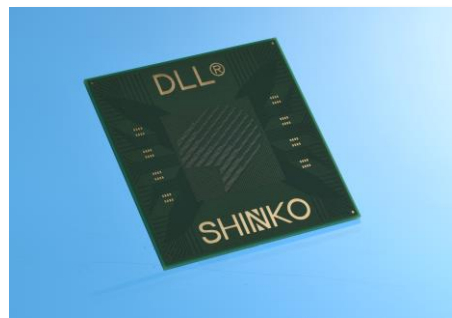
(単位：億円)

	2019年度 3Q累計	2020年度 3Q累計	前年同期比		2020年 3月期
				増減率	
売上高 (構成比)	230 (21%)	229 (17%)	▲1	▲0%	312

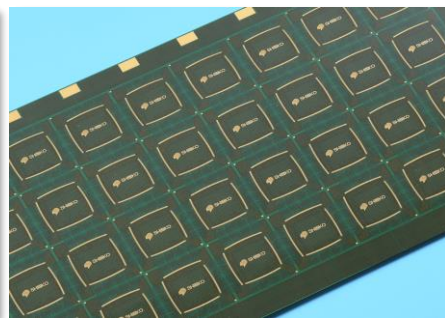
- QFNタイプが幅広い用途向けに需要が増加するとともに、自動車向け需要が底打ちしたことなどにより、第3四半期に入って売上が回復に転じた



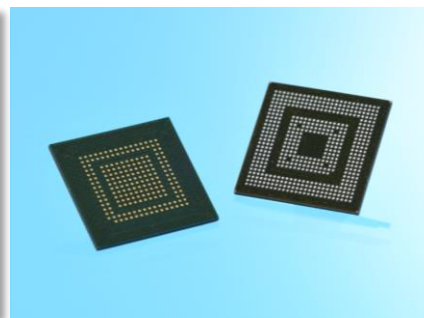
I Cパッケージ部門



フリップチップタイプ
パッケージ



プラスチックBGA基板



I C組立



ヒートスプレッダー

【主な搭載製品例】

パソコン、サーバー、スマートフォン、民生機器 他

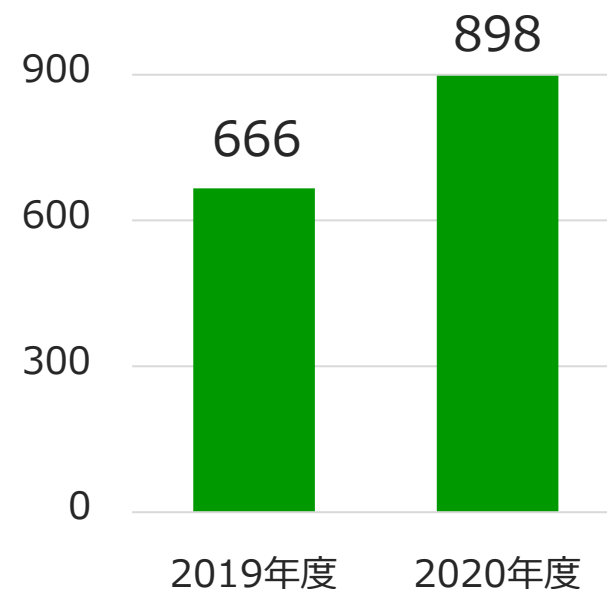
I Cパッケージ部門

（単位：億円）

	2019年度 3Q累計	2020年度 3Q累計	前年同期比		2020年 3月期
				増減率	
売上高 (構成比)	666 (62%)	898 (66%)	233	35%	924

- フリップチップタイプパッケージは、サーバー向けおよびパソコン向けに需要が大幅に拡大、大型設備投資を展開してきた高丘工場新ラインが10月より量産稼働を開始、売上増加に寄与
- プラスチックBGA基板は、新ラインの稼働開始により、先端メモリー向けに受注が大きく増加
- IC組立は、ハイエンドスマートフォン向けの需要拡大により、増収
- CPU向けヒートスプレッダーは、サーバー向けが堅調のまま推移

< 3Q累計売上高 >



気密部品部門



セラミック静電チャック



光学機器用ガラス端子



光通信用ガラス端子

【主な搭載製品例】

半導体製造装置、自動車、民生機器、通信機器 他

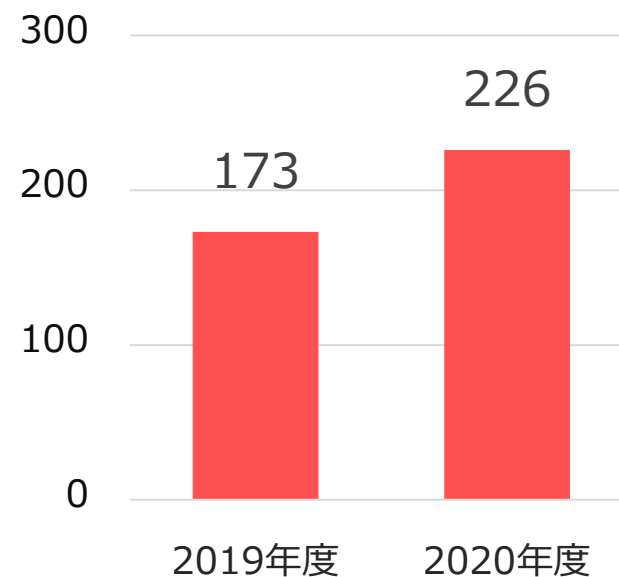
気密部品部門

（単位：億円）

	2019年度 3Q累計	2020年度 3Q累計	前年同期比		2020年 3月期
				増減率	
売上高 (構成比)	173 (16%)	226 (17%)	53	31%	240

- 半導体製造装置向けセラミック静電チャックは、旺盛な受注環境を背景に売上がさらに拡大
- ガラス端子は、第3四半期に回復傾向を示したが、期前半において光学機器向けが低調に推移したことなどにより、減収

< 3 Q累計売上高 >



業績予想の修正（2021/1/28公表）

（単位：億円）

	2020年度通期			
	前回予想 (2020/10/27)	今回予想 (2021/1/28)	前回予想との 増減額	増減比
売上高	1,773	1,829	56	3%
営業利益	135	187	52	39%
経常利益	147	200	53	36%
純利益※	100	134	34	34%
1株当たり当期純利益	74.02円	99.19円	—	—

※親会社株主に帰属する当期純利益

修正理由

- テレワーク、オンライン学習の拡大、5G実用化などを背景として、サーバーおよびパソコン向けにフリップチップタイプパッケージの受注が想定を上回って推移するとともに、大型の設備投資を展開してきたフリップチップタイプパッケージの新ラインの量産稼働開始が売上増加に寄与。
- 半導体製造装置市場における旺盛な需要を背景にセラミック静電チャックの売上がさらに増加。
- 第3四半期に入って自動車向け需要の底打ちなどにより、リードフレームの売上が回復に転じる。
- これらにより、売上、収益ともに想定を上回る状況にあり、特に収益面において、高付加価値製品をはじめとする売上増加による収益性の向上等により、予想を大きく上回って進捗。
- 引き続き第4四半期も半導体市場は堅調に推移することが見込まれ、受注環境は好調を維持することが想定されることをふまえ、昨年10月27日公表の通期業績予想数値を修正。
- 通期業績予想の前提となる第4四半期の為替レートを1米ドル=102円から100円に変更。

売上高・損益・配当

(単位：億円)

	2019年度 (実績)			2020年度 (上期実績・下期予想)			前年度比	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	通期	増減率
売上高	693	791	1,483	845	984	1,829	346	23%
営業利益 (営業利益率)	▲10 (▲1%)	42 (5%)	32 (2%)	72 (9%)	115 (12%)	187 (10%)	155	479%
経常利益 (経常利益率)	▲5 (▲1%)	53 (7%)	48 (3%)	83 (10%)	117 (12%)	200 (11%)	152	316%
純利益※ (四半期(当期)純利益率※)	▲10 (▲1%)	37 (5%)	27 (2%)	56 (7%)	78 (8%)	134 (7%)	107	398%

為替レート	107円/\$	第3四半期累計期間 実績 104円/\$	第4四半期 想定 100円/\$
-------	---------	-------------------------	---------------------

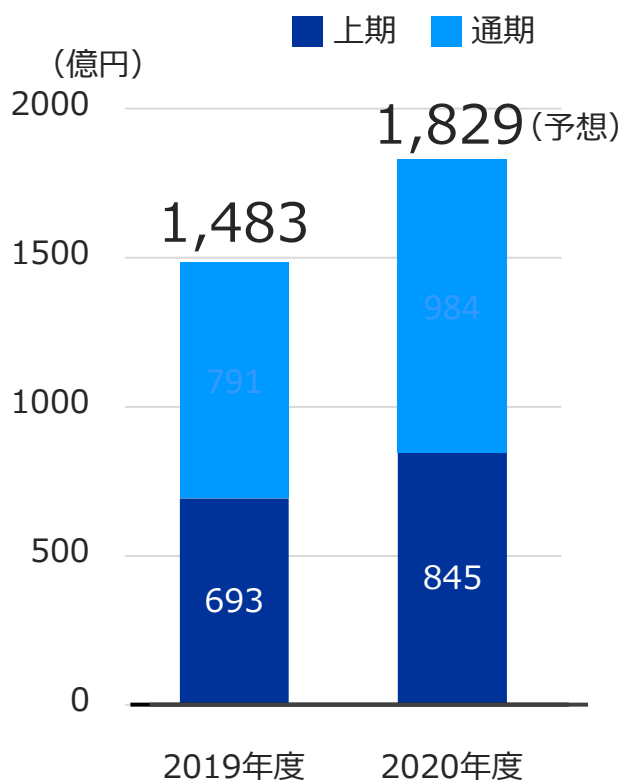
※親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益

(単位：円)

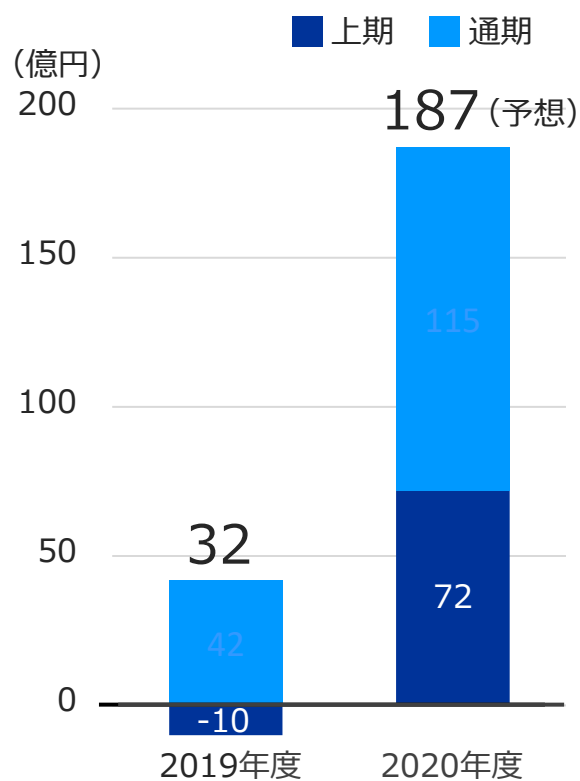
1株当たり配当金 (配当性向)	12.5 [中間]	12.5 [期末]	25.0 (126%)	12.5 [中間]	12.5 [期末]	25.0 (25%)
--------------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	---------------

2020年度 通期の見通し (連結)

売上高

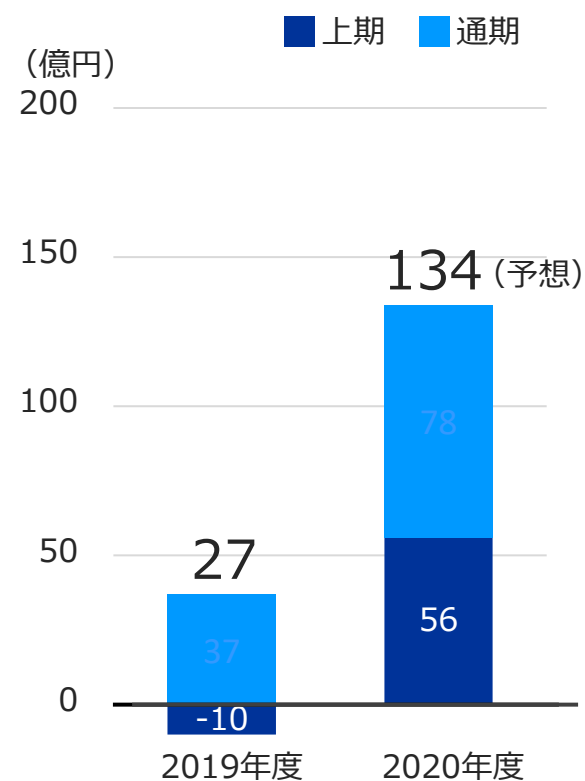


営業利益

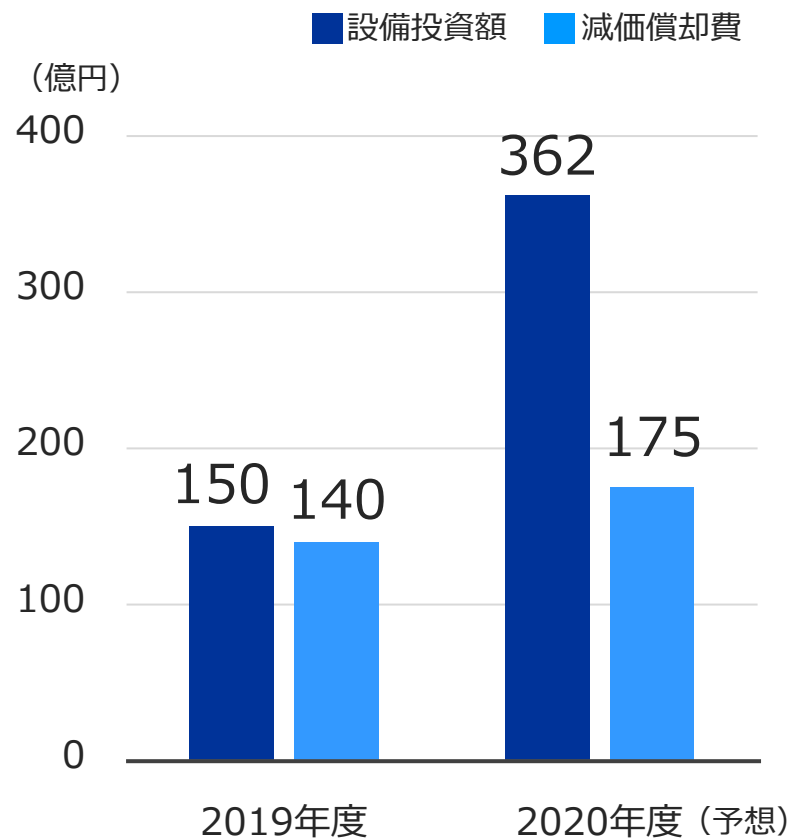


純利益*

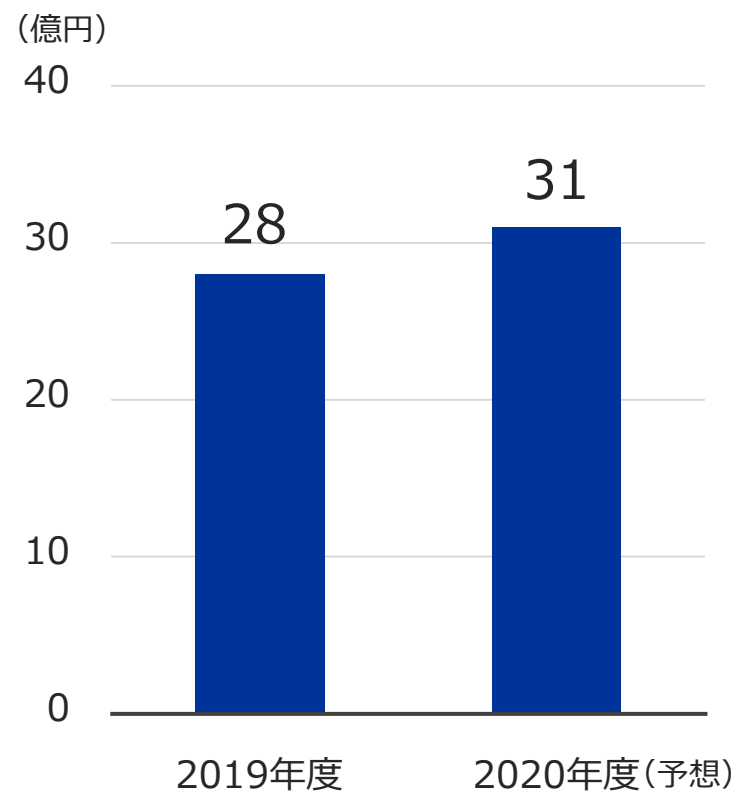
※親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益



設備投資額・減価償却費



研究開発費



本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手可能な情報および合理的と判断する一定の前提に基づくものであり、将来の予想数値の実現を保証するものではありません。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

また、本資料では、業績の概略として多くの数値は億円単位にて表示しております。決算短信等で百万単位で開示しております数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。詳細な数値が必要な場合は、決算短信または四半期報告書を参照していただきますようお願いいたします。